



## 《電通大と東芝メモリ、AI・半導体メモリで提携》

国立大学法人電気通信大学（東京都調布市、学長 福田喬）と東芝メモリ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 成毛康雄）は、2019年7月4日、AIを活用した生産技術をはじめ、半導体メモリに関する研究開発を協力して推進する連携協定を結びました。

本協定により、両者は「画像処理、生産制御、行動解析技術」、「次世代情報通信技術」、「ナノテクノロジー技術」等の分野において、半導体メモリに関する最先端の研究開発に取り組みます。半導体製造では品質と生産性を向上するために、製造装置や搬送システム等から収集した膨大なデータを用いて、オペレーションの自動化や複雑な要因解析を行っており、この連携による研究成果の応用が期待されます。また、人材交流を通じて若手科学技術者の育成、および研究活動を協力し、半導体メモリと半導体製造に関する科学技術の発展に貢献することを目指しています。

電気通信大学は、2013年に文部科学省の研究大学強化促進事業に採択され、また2016年7月には国立大学初の人工知能先端研究センターを開設するなど、時代を切り拓く科学技術の創出と人材育成に積極的に取り組んでいます。特に、人工知能（AI）やIoTなどの情報通信分野では、幅広い研究テーマに取り組んでおり、今回の東芝メモリ株式会社との連携を通じて、半導体メモリ分野におけるAI関連技術の社会還元を積極的に推進します。

一方、東芝メモリ株式会社では、デジタルプロセスイノベーションセンターにおいて半導体製造とビッグデータやAI、機械学習等を組み合わせた最先端の技術分野を研究しています。AIをはじめとする多様な分野でオープンイノベーションを加速するため、デジタルプロセスイノベーションセンターの拠点を渋谷に立ち上げ、研究活動や人材交流を推進します。

### お問い合わせ先

電気通信大学 総務企画課広報・基金・卒業生室広報係  
〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘一丁目5番地1  
Tel : 042-443-5019 Fax : 042-443-5887  
e-mail: kouhou-k@office.uec.ac.jp

### 東芝メモリ株式会社

経営企画部 山路 航太  
Tel: 03-6478-2319  
e-mail: tmchq-tmchd-info@ml.toshiba.co.jp